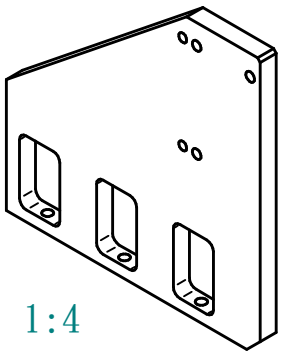
未標示表面加工符號	次序	訂正摘要	日期	負責人
▽▽	1			
未標示 圓角 1 R / 倒角 1 C	2			



孔與孔中心距公差 ±0.3 鑽孔、沉頭孔公差 +0.25 -0.05 角度±1°	表面處理	無電解鎳	圖 名	升降轉接板	
	材 料	S45C	檔 名	AM300升降轉接板-CE.dft	
	計畫代號		件 數	2 個	工件總類 機製件
			比 例	1/2	圖 號 升降轉接板

加工一般公差				
>0	±0.1	設 計	2016/11/12	莊傳勝
>6	±0.2	繪 圖	2016/11/12	莊傳勝
>30	±0.3	審 校		
>120	±0.5	核 准		
>315	±0.8		日期	姓名
>1000	±1.2			

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute